

海通证券股份有限公司

关于合肥新汇成微电子股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）



（上海市广东路 689 号）

二〇二二年三月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(下称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》(下称“《保荐管理办法》”)、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》(下称“《注册管理办法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(下称“《上市规则》”)等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会(下称“中国证监会”)、上海证券交易所的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

目 录

第一节 本次证券发行基本情况	3
一、本次证券发行保荐机构名称.....	3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况.....	3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员.....	3
四、本次保荐的发行人情况.....	3
五、本次证券发行类型.....	4
六、本次证券发行方案.....	4
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....	5
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见.....	5
第二节 保荐机构承诺事项	9
第三节 对本次证券发行的推荐意见	10
一、本次证券发行履行的决策程序.....	10
二、发行人符合科创板定位的说明.....	10
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件.....	12
四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件.....	13
五、发行人私募投资基金备案的核查情况.....	17
六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论.....	17
七、发行人存在的主要风险.....	18
八、发行人市场前景分析.....	25
九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.....	31
十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论.....	32
附件:	33
首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书	35

第一节 本次证券发行基本情况

一、本次证券发行保荐机构名称

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）

二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况

本保荐机构指定何立、吴俊担任合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。

何立：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部高级副总裁，持有法律职业资格证书，2017年起从事投资银行业务，曾负责或参与骏成科技IPO、之江生物IPO、肇民科技IPO、安图生物可转债、蓝天燃气IPO、天海电子IPO、湖南华菱钢铁集团可交换债券等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

吴俊：本项目保荐代表人，海通证券投资银行总部董事总经理、注册会计师，2011年起从事投资银行业务，主要负责或参与了鹏辉能源IPO、立昂技术IPO、上海雅仕IPO、嘉泽新能IPO、金力永磁IPO、金博股份IPO、凯因科技IPO、肇民科技IPO、骏成科技IPO，以及金风科技（A+H）配股、鹏辉能源可转债、泰瑞机器非公开发行股票、立昂技术重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。

三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员

1、项目协办人及其保荐业务执业情况

项目原协办人已离职，本项目无协办人。

2、项目组其他成员

本次发行项目组的其他成员：张鹏、奚颢、叶晟、邢丞栋、张岩、李倩、邓欣、张旭鸿

四、本次保荐的发行人情况

公司名称	合肥新汇成微电子股份有限公司
------	----------------

英文名称	Union Semiconductor (Hefei) Co., Ltd.
注册资本	66,788.2625 万元
法定代表人	郑瑞俊
有限公司成立日期	2015 年 12 月 18 日
股份公司成立日期	2021 年 3 月 30 日
住所	合肥市新站区合肥综合保税区内
邮政编码	230012
电话	0551-67139968-7099
传真	0551-67139968-7099
公司网址	www.unionsemicon.com.cn
电子信箱	zhengquan@unionsemicon.com.cn
负责信息披露和投资者关系的部门	董事会办公室
负责信息披露和投资者关系的部门负责人	施周峰
负责信息披露和投资者关系的部门联系电话	0551-67139968-7099

五、本次证券发行类型

股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市。

六、本次证券发行方案

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 222,627,542 股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%，不超过 25%（行使超额配售选择权之前）
其中：发行新股数量	不超过 222,627,542 股（行使超额配售选择权之前）	占发行后总股本比例	不低于 10%，不超过 25%（行使超额配售选择权之前）
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 890,510,167 股（行使超额配售选择权之前）		
战略配售情况	本次发行及上市拟采用战略配售，战略配售的对象包括但不限于保荐机构相关子公司、公司的高级管理人员与核心员工依法设立的专项资产管理计划等，具体安排参照上海证券交易所相关规定执行。相应战略配售的对象后续将进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上海证券交易所提交相关文件并依法披露		
发行方式	本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或证券监管部门认可的其他发		

	行方式
发行对象	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司开立账户的合格投资者或证券监管部门认可的其他发行对象
承销方式	余额包销
发行费用的分摊原则	本次发行的保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等其他费用均由公司承担

七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

1、辽宁海通新动能股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海通新动能”）共持有发行人 1.91% 股权。海通开元投资有限公司（以下简称“海通开元”）系本保荐机构全资子公司，海通开元持有海通新能源私募股权投资管理有限公司（以下简称“海通新能源”）51.00% 股权，海通新能源系海通新动能执行事务合伙人并持股 0.67%；海通开元另持有海通新动能 19.33% 股权。因此，本保荐机构全资子公司海通开元通过海通新动能间接持有发行人 0.37% 的股份，通过海通新能源间接持有发行人 0.01% 的股份，本保荐机构合计持有发行人 0.38% 的股份。此外，本保荐机构将按照交易所相关规定，安排相关子公司参与发行人本次发行战略配售。除此之外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶、董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况；

4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

5、本保荐机构与发行人之间不存在其他关联关系。

八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见

（一）内部审核程序

海通证券对本次发行项目的内部审核经过了立项评审、申报评审及内核三个

阶段。

1、立项评审

本保荐机构以保荐项目立项评审委员会（以下简称“立项评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否批准立项。具体程序如下：

（1）凡拟由海通证券作为保荐机构向中国证监会、上海证券交易所推荐的证券发行业务项目，应按照《海通证券股份有限公司保荐项目立项评审实施细则》之规定进行立项。

（2）项目组负责制作立项申请文件，项目组的立项申请文件应经项目负责人、分管领导同意后报送质量控制部；由质量控制部审核出具审核意见并提交立项评审会审议；立项评审会审议通过后予以立项。

（3）获准立项的项目应组建完整的项目组，开展尽职调查和文件制作工作，建立和完善项目尽职调查工作底稿。

2、申报评审

本保荐机构以保荐项目申报评审委员会（以下简称“申报评审会”）方式对保荐项目进行审核，评审会委员依据其独立判断对项目进行表决，决定项目是否提交公司内核。具体程序如下：

（1）项目组申请启动申报评审程序前，应当完成对现场尽职调查阶段工作底稿的获取和归集工作，并提交质量控制部验收。底稿验收通过的，项目组可以申请启动申报评审会议审议程序。

（2）项目组在发行申请文件制作完成后，申请内核前，需履行项目申报评审程序。申报评审由项目组提出申请，并经保荐代表人、分管领导审核同意后提交质量控制部，由质量控制部审核出具审核意见并提交申报评审会审议。

（3）申报评审会审议通过的项目，项目组应及时按评审会修改意见完善发行申请文件，按要求向内核部报送内核申请文件并申请内核。

3、内核

内核部为本保荐机构投资银行类业务的内核部门，并负责海通证券投资银行

类业务内核委员会（以下简称“内核委员会”）的日常事务。内核部通过公司层面审核的形式对投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。内核委员会通过召开内核会议方式履行职责，决定是否向中国证监会、上海证券交易所推荐发行人股票、可转换债券和其他证券发行上市，内核委员根据各自职责独立发表意见。具体工作流程如下：

（1）投资银行业务部门将申请文件完整报送内核部门，材料不齐不予受理。应送交的申请文件清单由内核部门确定。

（2）申请文件在提交内核委员会之前，由内核部门负责预先审核。

（3）内核部门负责将申请文件送达内核委员，通知内核会议召开时间，并由内核委员审核申请文件。

（4）内核部门根据《海通证券股份有限公司投资银行类项目问核制度》进行问核。

（5）召开内核会议，对项目进行审核。

（6）内核部门汇总整理内核委员审核意见，并反馈给投资银行业务部门及项目人员。

（7）投资银行业务部门及项目人员回复内核审核意见并根据内核审核意见进行补充尽职调查（如需要），修改申请文件。

（8）内核部门对内核审核意见的回复、落实情况进行审核。

（9）内核委员独立行使表决权并投票表决，内核机构制作内核决议，并由参会内核委员签字确认。

（10）内核表决通过的项目在对外报送之前须履行公司内部审批程序。

（二）内核委员会意见

2021年9月6日，本保荐机构内核委员会就合肥新汇成微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目召开了内核会议。内核委员会经过投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关要求，同意推荐发行人股票发行上市。

由于申报基准日调整，2021年10月25日，本保荐机构内核委员会就合肥新汇成微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市项目再次召开了内核会议。内核委员会经过投票表决，认为发行人申请文件符合有关法律、法规和规范性文件中关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关要求，同意推荐发行人股票发行上市。

第二节 保荐机构承诺事项

本保荐机构承诺：

一、本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会及上海证券交易所的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

二、本保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及本保荐机构的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、中国证监会规定的其他事项。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、本次证券发行履行的决策程序

本保荐机构对发行人本次发行履行决策程序的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行已履行了《公司法》、《证券法》及《注册管理办法》等中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序，具体情况如下：

1、董事会审议过程

2021年6月10日，发行人召开第一届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于〈合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年分红回报规划〉的议案》《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意将相关议案提交发行人2020年年度股东大会审议。

2、股东大会审议过程

2021年6月30日，发行人召开2020年年度股东大会。该次股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所科创板上市的议案》《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》《关于〈合肥新汇成微电子股份有限公司未来三年分红回报规划〉的议案》《关于公司填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺的议案》等关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关议案。

二、发行人符合科创板定位的说明

（一）公司符合行业领域要求

公司所属行业	<input checked="" type="checkbox"/> 新一代信息技术	（1）公司是集成电路高端先进封装测试服务商，封装测试服务主要应用于LCD、AMOLED等各类主流面板的显示驱动芯片。公司
--------	---	--

领域	<input type="checkbox"/> 高端装备	<p>主营业务以前段金凸块制造（Gold Bumping）为核心，并综合晶圆测试（CP）及后段玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）环节，形成显示驱动芯片全制程封装测试综合服务能力。其中前段金凸块制造工序是后段倒装封装（FlipChip）工艺（即 COG 和 COF）得以实现的关键技术。</p> <p>（2）根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）；根据《国民经济行业分类与代码》（GB/4754-2017），公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）下属的集成电路制造业（C3973），具体细分行业为集成电路封装测试业。</p> <p>（3）根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版），公司主要封装技术属于“1.3 电子核心产业”之“1.3.1 集成电路”中的“集成电路芯片封装，采用 SiP、MCP、MCM、CSP、WLP、BGA、FlipChip、TSV 等技术的集成电路封装。”，同时公司所封测的显示驱动芯片亦属于《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016 版）之“1.3.2 新型显示器件”之“新型显示材料”之“驱动 IC”。</p> <p>（4）根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“1 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造业”。</p> <p>（5）除上述国家级分类外，公司所掌握的凸块制造技术亦为各省人民政府发展集成电路产业的重点支持方向之一。2018 年 2 月，安徽省政府办公厅发布《安徽省半导体产业发展规划（2018-2021 年）》，表示“提升封装测试业层次。依托长电科技、通富微电、新汇成等企业，大力发展凸块（Bumping）、倒装（Flip Chip）、晶圆级封装（WL-CSP）、硅通孔（TSV）等先进封装技术”。2020 年 2 月，广东省人民政府办公厅发布《广东省人民政府办公厅关于印发广东省加快半导体及集成电路产业发展若干意见的通知》，提出“大力发展晶圆级封装、系统级封装、凸块、倒装、硅通孔、面板级扇外型封装、三维封装、真空封装等先进封装技术”。</p> <p>（6）根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2021 年修订），公司属于第四条第（一）款规定的新一代信息技术领域。</p>
	<input type="checkbox"/> 新材料	
	<input type="checkbox"/> 新能源	
	<input type="checkbox"/> 节能环保	
	<input type="checkbox"/> 生物医药	
<input type="checkbox"/> 符合科创板定位的其他领域		

（二）公司符合科创属性要求

科创属性评价标准一	是否符合	指标情况
最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6,000 万元	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司研发投入分别为 4,542.64 万元、4,715.21 万元和 6,060.30 万元，最近三年累计研发投入金额为 15,318.15 万元，超过 6,000 万元；最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入的比例为 8.47%，超过 5%
研发人员占当年员工总数的比例>10%	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	截至 2021 年 12 月 31 日，研发人员占当年员工总数比例为 15.85%，超过 10%
形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5 项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	形成主营业务收入的产品涉及 18 项发明专利，超过 5 项
最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3 亿	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	最近三年，公司营业收入分别为 39,420.66 万元、61,892.67 万元和 79,569.99 万元，复合增长率为 42.07%，超过 20%；2021 年实现营业收入 79,569.99 万元，超过 3 亿元

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

本保荐机构对发行人符合《证券法》关于首次公开发行新股条件的情况进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为发行人本次发行符合《证券法》规定的发行条件，具体情况如下：

1、发行人具备健全且运行良好的组织机构

根据发行人《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》等内部控制制度及本保荐机构的适当核查，发行人已依法建立了包含股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等的公司治理体系。发行人目前有7名董事，其中3名为发行人聘任的独立董事；董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会；发行人设3名监事，其中1名是由职工代表担任的监事。

根据本保荐机构的适当核查以及发行人的说明、发行人审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师”）出具的天健审〔2022〕279号《合肥新汇成微电子股份有限公司内部控制鉴证报告》、发行人律师安徽天禾律师事务所出具的《关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的法律意见书》、《关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之补充法律意见书（二）》，发行人报告期内股东大会、董事会、监事会能够依法召开，运作规范；股东大会、董事会、监事会决议能够得到有效执行；重大决策制度的制定和变更符合法定程序。

综上所述，发行人具有健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定。

2、发行人具有持续经营能力

根据天健会计师出具的天健审〔2022〕278号审计报告，发行人2019年、2020年和2021年实现营业收入分别为39,420.66万元、61,892.67万元及79,569.99万元，年复合增长率达42.07%，具有较高的成长性。发行人现有客户主要为境内外上市企业，客户资源优质且合作关系稳定，是发行人能够持续经营的坚实保障。

发行人现有主营业务或投资方向能够保证其可持续发展，经营模式和投资计划稳健，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。发行人

经营规模不断扩大，业务成长性较高，客户资源稳定、优质，具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定。

3、发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

天健会计师针对发行人最近三年一期的财务报告出具了天健审〔2022〕278号审计报告，认为发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了合肥新汇成微电子股份有限公司2019年12月31日、2020年12月31日和2021年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度、2020年度和2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

根据各有权机构出具的证明文件，公司及下属子公司最近三年认真执行国家及地方有关法律法规，未发生重大违反法律法规的行为。

发行人最近三年财务会计文件无虚假记载，无其它重大违法行为，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定。

4、发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据公安机关出具的无犯罪记录证明、相关行政管理部门出具的合规证明等，发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项的规定。

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件

本保荐机构根据《注册管理办法》对发行人及本次发行的相关条款进行了逐项核查。经核查，本保荐机构认为，发行人本次发行符合中国证监会关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关规定。本保荐机构的结论性意见及核查过程和事实依据的具体情况如下：

（一）发行人的主体资格

发行人是依法设立且持续经营3年以上的股份有限公司，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营

时间可以从有限责任公司成立之日起计算。

1、本保荐机构调阅了发行人的工商档案、营业执照等有关资料，2015年12月，公司前身合肥新汇成微电子有限公司（简称“汇成有限”）完成工商注册。2021年3月，汇成有限召开股东会会议，同意以2021年1月31日为基准日，将汇成有限整体变更为股份有限公司，股份制改造后名称变更为合肥新汇成微电子股份有限公司。截至目前，公司仍然依法存续。发行人是依法设立并有效存续的股份有限公司，符合《注册办法》第十条的规定。

2、发行人按原有限公司账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，自有限公司成立之日起计算，已持续经营三年以上，符合《注册办法》第十条的规定。

（二）发行人的财务与内控

发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具无保留意见的审计报告。

发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具无保留结论的内部控制鉴证报告。

1、本保荐机构查阅了发行人相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范；天健会计师出具了天健审〔2022〕278号无保留意见的审计报告，发行人财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了发行人报告期内财务状况、经营成果、现金流量。符合《注册办法》第十一条第一款之规定。

2、本保荐机构查阅了发行人内部控制制度，确认发行人内部控制在所有重大方面是有效的。天健会计师出具了天健审〔2022〕279号《合肥新汇成微电子股份有限公司内部控制鉴证报告》，发行人按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。符合《注册办法》第十一条第二款之规定。

（三）发行人的持续经营

发行人业务完整，具有直接面向市场独立持续经营的能力：

1、资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

本保荐机构深入了解发行人的商业模式，查阅了发行人主要合同、实地走访及视频访谈了主要客户及供应商，与发行人主要职能部门、高级管理人员和主要股东进行了访谈，了解了发行人的组织结构、业务流程和实际经营情况。确认发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力。

经核查，发行人资产完整、人员、财务、机构及业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《注册办法》第十二条第一款之规定。

2、发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化；控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东所持发行人的股份权属清晰，最近 2 年实际控制人没有发生变更，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。

本保荐机构查阅了发行人公司章程、历次董事会、股东大会决议和记录，查阅了工商登记文件，查阅了发行人财务报告，确认发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定；最近2年内主营业务和董事、高级管理人员及核心技术人员的变动不属于重大不利变化的情形；最近2年内公司控制权没有发生变更；最近2年内公司主要股东所持发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷。发行人符合《注册办法》第十二条第二款之规定。

3、发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。

(1) 本保荐机构查阅了发行人主要资产、核心技术、商标等的权属文件，确认发行人主要资产、核心技术、商标等权属清晰，不存在重大权属纠纷的情况。保荐机构向银行取得了发行人担保的相关信用记录文件，核查了发行人相关的诉

讼和仲裁文件，发行人不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。

(2) 本保荐机构查阅分析了相关行业研究资料、行业分析报告及行业主管部门制定的行业发展规划等，核查分析了发行人的经营资料、财务报告和审计报告等，确认不存在经营环境已经或者将要发生重大变化等对发行人持续经营有重大不利影响的事项。发行人符合《注册办法》第十二条第三款之规定。

(四) 发行人的规范运行

1、发行人生产经营符合法律、行政法规的规定，符合国家产业政策。

本保荐机构查阅了发行人章程，查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，查阅了发行人生产经营所需的各项政府许可、权利证书或批复文件等，实地查看了发行人生产经营场所，确认发行人主营业务均围绕集成电路的封装测试业务的研发、生产与销售展开。产品符合产业升级发展方向，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019本）》所规定的鼓励类。

发行人的生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策。因此发行人符合《注册办法》第十三条第一款之规定。

2、最近 3 年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。

董事、监事和高级管理人员不存在最近 3 年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

(1) 本保荐机构取得了发行人关于不存在重大违法违规情况的说明，获取了相关部门出具的证明文件，确认最近3年内，发行人及其控股股东、实际控制人不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。因此发行人符合《注册办法》第十三条第二款之规定。

(2) 本保荐机构查阅了中国证监会、证券交易所的公告，访谈发行人董事、监事和高级管理人员，取得了相关人员的声明文件，确认发行人董事、监事和高级管理人员不存在最近3年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。因此，发行人符合《注册办法》第十三条第三款之规定。

五、发行人私募投资基金备案的核查情况

截至本发行保荐书出具日，发行人股东中共有 14 家股东属于私募基金规则所规范的私募投资基金，均已完成基金管理人登记及基金备案的手续，具体情况如下：

序号	股东名称	基金编号	备案时间	基金管理人名称	管理人编号
1	高投邦盛	S20237	2014/8/18	江苏邦盛股权投资基金管理有限公司	P1001650
2	合肥创投	SD4606	2014/10/15	合肥产投资本创业投资管理有限公司	P1071755
3	国耀汇成	SNJ019	2020/12/24	合肥国耀资本投资管理有限公司	P1070881
4	鼎祥基金	SJ8599	2016/7/14	四川鼎祥股权投资基金有限公司	P1017268
5	十月吴巽	SCC708	2018/1/11	宁波十月桐生投资管理合伙企业（有限合伙）	P1065078
6	拾岳禾安	SJJ558	2019/12/4	合肥拾岳投资管理合伙企业（有限合伙）	P1069486
7	康启一号	SNB444	2020/11/5	芜湖元祐投资管理有限公司	P1066906
8	惠友豪创	SLE922	2020/6/24	深圳市惠友创盈投资管理有限公司	P1023992
9	昆桥基金	SGY603	2020/1/14	昆桥资本股权投资管理（深圳）有限公司	P1070031
10	语音基金	SGD978	2019/6/20	合肥产投资本创业投资管理有限公司	P1071755
11	华登基金	SNC493	2020/12/18	华芯原创（青岛）投资管理有限公司	P1060141
12	旭鼎一号	SNT016	2021/1/21	北京朗姿韩亚资产管理有限公司	P1069524
13	海通新动能	SJX017	2020/5/18	海通新能源私募股权投资管理有限公司	GC1900031593
14	道银投资	SND885	2020/10/30	信达风投资管理有限公司	P1004370

六、发行人审计截止日后经营状况的核查结论

经核查，保荐机构认为：财务报告审计截止日至本发行保荐书出具日，发行人所处集成电路封装测试行业及市场发展情况较好，发行人总体经营情况良好，

经营模式未发生重大变化；发行人客户结构稳定，主要供应商合作情况良好，不存在重大不利变化；发行人研发投入、相关税收优惠政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项未发生重大变化。

七、发行人存在的主要风险

（一）技术风险

1、技术升级迭代的风险

随着显示面板性能需求的不断提升，OLED 等新型显示面板技术以及触控与显示驱动芯片集成技术的出现，显示驱动芯片技术朝着高分辨率、高帧率、高带宽、外围器件较少与功能高度集成化的方向发展。为了满足上述行业发展趋势，显示驱动芯片封测企业需通过设计及工艺的创新不断提升产品性能，为新产品的开发带来了更多的挑战，亦促进了 Bumping、COG 与 COF 等封装技术的发展。

目前发行人专注于显示驱动芯片先进封测领域，主要使用 Bumping、COG、COF 等技术。如果未来公司技术升级进度或成果未达预期、未能准确把握行业发展趋势，导致未能成功进行工艺及技术升级迭代，公司市场竞争力将受到不利影响。

2、公司综合技术实力与全球行业龙头相比存在差距的风险

在整个集成电路封测行业，主要公司日月光、Amkor、长电科技、通富微电、华天科技产品线均横跨封测行业多个细分领域。在显示驱动芯片封测领域，头部企业硕邦科技、南茂科技依托原有技术布局其他细分领域多年，积极开拓新的产品线。公司在封测行业其他细分领域的研发能力与技术实力仍处于积累阶段，与行业头部公司存在一定差距。

在未来，如果公司未能实现其他细分领域封装工艺的研发，弥补与行业头部公司在研发能力与技术实力方面的差距，将对公司业务拓展、收入增长和持续经营带来不利影响。

3、其他常见的技术风险

公司所处集成电路封测行业为典型的技术密集型行业，面临核心技术人员流失或不足、技术泄密等高科技企业共同面临的技术风险。

显示驱动芯片封测行业对技术人员专业程度、经验水平均有较高要求。目前中国大陆显示驱动芯片封测行业人才缺口较大，行业内人才争夺较为激烈、人员流动较为频繁。若公司核心技术人员流失或无法继续培养或招揽，将对公司的研发生产造成较大不利影响。

核心技术是公司保持竞争优势的有力保障，若公司相关核心技术内控制度不能得到有效执行，或者出现重大疏忽、恶意串通等行为而导致公司核心技术泄露，将对公司的核心竞争力产生负面影响。

（二）经营风险

1、收入来源结构单一的风险

自成立以来，发行人一直专注于显示驱动芯片领域，由于公司目前阶段投资能力有限，尚未正式开展其他领域业务。报告期内，发行人主营业务收入分别为 37,001.73 万元、57,504.79 万元和 76,593.90 万元，均来源于显示驱动芯片的封装测试服务，占营业收入比例分别为 93.86%、92.91%和 96.26%，收入来源结构较为单一。

如果发行人在显示驱动芯片领域客户订单流失或议价能力下降，未能及时完成显示驱动芯片封测领域新的封测技术，以及 CMOS 图像传感器等其他芯片封装工艺的研发及产业化，将可能对发行人的经营业绩产生不利影响。

2、市场竞争加剧及公司综合竞争力相对行业头部企业较小的风险

近年来，集成电路封装测试行业竞争日趋激烈，显示驱动芯片封测领域资本不断涌入。一方面，境内行业龙头企业不断拓展产品线，如通富微电 2017 年立项研究 12 吋晶圆金凸块制造技术，进军显示驱动芯片封测领域。另一方面，外资与合资封装测试企业进一步布局中国境内市场，如同兴达 2021 年宣布与日月光半导体（昆山）有限公司以项目合作模式共同打造“芯片金凸块（Gold Bump）全流程封装测试项目”。

报告期内，公司主营业务收入分别为 37,001.73 万元、57,504.79 万元及 76,593.90 万元，相比显示驱动芯片封测行业头部企业硕邦科技、南茂科技等，公司业务规模仍存在较大差距。硕邦科技、南茂科技发展历史较为悠久，总资产、净资产、营业收入、净利润等经营指标均高于公司，研发费用和研发涉及领域等

研发指标均大于公司。

公司起步较晚，受资金、规模等方面的限制，综合竞争力亟待提升。在业务快速扩张的过程中，如果公司不能很好地应对同行业龙头企业竞争中的规模优势，将可能导致公司业务发展受阻；此外，境内外龙头企业的双重竞争态势愈发激烈，市场竞争加剧的风险可能使公司的业务受到一定冲击。

3、客户集中度较高的风险

报告期内，发行人对前五大客户的主营业务收入合计分别为 30,483.40 万元、43,824.32 万元和 56,284.51 万元，占主营业务收入的比例分别为 82.38%、76.21% 和 73.48%，客户集中度较高。如果未来发行人的主要客户生产经营出现问题，导致其向发行人下达的订单数量下降，或发行人无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新的客户资源，将可能对发行人经营业绩产生不利影响。

4、供应商集中度较高的风险

报告期内，发行人向前五大原材料供应商采购额合计分别为 17,621.61 万元、21,303.97 万元和 28,053.53 万元，占原材料采购总额的比例分别为 79.92%、83.14% 和 83.79%，原材料供应商集中度较高。如果公司主要供应商生产经营发生重大变化，或交付能力未能满足公司要求，或与公司业务关系发生变化，公司在短期内可能面临原材料短缺，从而对公司的生产经营产生不利影响。

5、区域贸易政策变化导致的风险

集成电路封装测试行业对原材料和设备有较高要求，发行人报告期内 80% 以上生产设备与 40% 以上原材料均采购自中国境外（以日本为主，具体以设备与原材料原产地为统计口径）；同时，发行人的主要客户亦为境外企业（以中国台湾地区为主），报告期内，公司对境外客户（以直接客户注册所在地为统计口径）销售金额占主营业务收入的比例在 70% 以上。

如果未来相关国家或地区与中国的区域贸易政策发生重大变化，限制进出口或提高关税，公司可能面临生产设备、原材料短缺和客户流失等情形，进而导致公司生产受限、订单减少、成本增加，对公司的业务和经营产生不利影响。

6、固定资产投资大，相关折旧对盈利能力影响较大的风险

公司所处集成电路封装测试行业属于资金密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资。同时，大规模的资金投入后，生产线从设备工艺调试，到产品下游验证，再到大规模量产，都需要技术人员对生产线各个环节的技术参数、制造工艺等进行不断的调整与严格的把控。基于该行业特点，集成电路封装测试的生产线安装后由于设备调试、生产组织、操作人员的熟练度等因素通常需要经历一段达产期。

报告期内，公司持续加大投资力度，固定资产规模持续增加，对应所产生的折旧费用保持在较高水平，各期折旧费用金额分别为 9,834.00 万元、13,859.70 万元和 16,897.19 万元。因此，在达产期前期，大额的长期资产折旧与摊销等固定成本将在一定程度上影响公司的盈利能力。

7、公司未来发展受限于资金投入规模的风险

鉴于集成电路封装测试重资产的行业属性，发行人未来扩建场地、购置设备扩充产能，开拓 CMOS 图像传感器、指纹传感器、射频识别等芯片封测领域，实现铜柱凸块、锡凸块等凸块制造工艺，均需大规模投入资金。如果发行人未来资金筹措能力受限，有可能影响未来的业绩增长空间。

8、其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期的风险

发行人计划未来投入大量资金持续建设研发中心、吸纳技术人才，研发凸块制造技术及 CMOS 图像传感器等其他细分领域封装技术。如果发行人未来在其他芯片封测细分领域客户开拓结果不及预期，有可能影响未来的业绩增长空间。

9、产业政策变化的风险

集成电路产业作为信息产业的基础和核心，是国民经济和社会发展的战略性新兴产业。近年来，国家出台了包括《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》《关于支持集成电路产业和软件产业发展进口税收政策的通知》等在内的一系列政策，从财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场等方面为集成电路企业提供了更多的支持，以推动集成电路行业发展，增强信息产业创新能力和国际竞争力。如果未来国家相关产业政策出现重大不利变化，将对公司发展产生一定不利影响。

（三）内控风险

1、实际控制人借款金额较大，存在影响公司实际控制人稳定性的风险

本次公开发行前，实际控制人郑瑞俊、杨会夫妇合计共同控制发行人 38.78% 的表决权，本次公开发行后控制比例将进一步下降。公司所处行业为资金密集型行业，固定资产投资规模较大，公司实际控制人郑瑞俊为支持公司发展、为员工持股平台支付增资款以吸引优秀人才和维持团队稳定，以及受让股东持有的部分股权，资金需求较大，存在以个人名义对外借款的情形。截至本发行保荐书签署日，公司实际控制人郑瑞俊存在多项未到期的大额负债，借款本金超过 3 亿元，负债到期时间为 2025 年 1 月至 2026 年 9 月不等。

自发行人完成首次公开发行股票并上市之日起三年后或大额负债到期后，如实际控制人不能按期偿还借款，则届时实际控制人持有的公司股份可能被债权人要求冻结、处置，存在对公司实际控制人稳定性造成不利影响的风险。

2、公司规模扩张带来的管理风险

报告期初，由于合肥生产基地实际订单数量与前期预测存在一定偏差，导致公司人员储备有所冗余、人力成本过高，造成公司盈利能力降低。本次发行上市后，公司规模将进一步增长，这将对管理层的管理能力带来更大的挑战。

未来，如果公司的管理水平不能满足业务规模扩大对公司各项规范治理的要求，将会对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

3、财务内控不规范的风险

在公司发展过程中，公司因资金链紧张、融资渠道少等客观原因，发生了如转贷、资金拆借等财务内控不规范的行为。针对上述内控问题，公司已积极进行整改，但若未来财务内控制度不能得到有效执行或内控不规范的情形再度发生，可能存在导致公司利益受损进而损害投资者利益的风险。

（四）财务风险

1、报告期内，公司毛利率波动较大，且未来毛利率增长不可持续的风险

报告期内，公司综合毛利率分别为 4.91%、19.41% 和 29.62%，毛利率波动较大，呈快速上涨的趋势，主要原因系：1、随着国家产业政策的扶持鼓励、显

示面板产业链向大陆转移加速以及终端应用领域的需求提升，显示驱动芯片封测服务需求持续增长；2、随着合肥 12 吋封测基地产能利用率快速攀升、产量持续提高产生规模效应，公司产品单位固定成本下降；3、随着生产经营管理水平提升及经验曲线效应显现，公司适时筹划人员优化，有效降低单位人力成本；4、公司高度重视研发投入，不断提高封测服务质量与生产良率、降低生产成本，吸引客户导入高端产品，以提供高附加值服务。

如果未来国家产业政策调整、显示驱动芯片封测需求下滑，伴随着显示驱动芯片封测市场竞争日趋激烈，公司可能无法获取充足的客户订单形成生产规模效应，以及公司生产及管理能力水平若无法适应未来发展，造成人力成本过高，将使得公司封测服务的单位成本处于较高水平；或者公司研发未来受限于资金规模，不能持续有效地实施业务发展规划，保持技术与服务的领先性，提供高附加值服务，均可能导致公司毛利率无法保持较高水平。因此，公司未来毛利率增长存在不可持续的风险。

2、存在累计未弥补亏损的风险

截至 2021 年末，公司经审计的累计未弥补亏损为-22,400.72 万元，累计未弥补亏损的情形尚未消除，主要系所处集成电路封装测试行业属于资金密集型及技术密集型行业，要形成规模化生产，需要进行大规模的固定资产投资及研发投入。在首次公开发行股票并在科创板上市后，若公司短期内无法弥补累计亏损，将导致缺乏向股东现金分红的能力。

3、存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,176.49 万元、12,439.05 万元和 17,063.90 万元，占各期末流动资产的比例分别为 43.02%、30.90%和 36.66%。公司期末存货金额较大，占比较高，并且公司存货金额可能随着公司业务规模扩大进一步增长，占用公司较多的经营资金。如果未来市场需求、价格发生不利变动，可能导致公司存货积压、跌价，公司营运资金压力增加，从而对公司经营业绩造成不利影响。

4、业绩波动的风险

报告期内，公司营业收入分别为 39,420.66 万元、61,892.67 万元和 79,569.99

万元，净利润分别为-16,402.95 万元、-400.50 万元和 14,031.82 万元，业绩波动较大。2019 年和 2020 年净利润均为负，主要系公司处于持续的客户验证及产品导入阶段，销售收入不能覆盖同期发生的成本及研发支出，长期资产折旧与摊销金额等成本较高所致。如果未来宏观经济景气度下行、国家产业政策出现变化、行业竞争加剧等原因导致市场对公司主要产品供需关系发生变化，可能对公司业务产生影响，公司存在业绩波动的风险。

5、政府补助政策变化的风险

集成电路行业系国家重点战略产业，各级政府或主管部门给予的补助政策较多，报告期内，公司计入当期损益的政府补助分别为 665.29 万元、4,370.80 万元和 4,296.13 万元。如果未来相关政策发生变化，公司政府补助规模无法延续，将对公司经营业绩造成一定影响。

6、汇率波动风险

公司的记账本位币为人民币，主要交易采用美元、日元等外币计价。报告期内，受汇率波动的影响，公司汇兑损益分别为 404.48 万元、520.87 万元和 70.20 万元。如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司将面临汇兑损失的风险。

（五）募集资金投资项目风险

1、募集资金投资项目的市场风险

本次募集资金拟主要投资于公司的扩产项目建设。本次募集资金投资项目金额较大，投资回收期较长，募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关。如果募集资金投资项目未能按照计划顺利实施，公司则可能面临无法按既定计划实现预期收益的风险。

2、募投项目新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

本次募集资金投资项目规模较大，募投项目实施后固定资产规模将大幅增加。公司主要募投项目“12 吋显示驱动芯片封测扩能项目”建设投资为 93,004.85 万元，根据公司折旧政策，项目达产后将每年新增折旧摊销费用 8,189.05 万元，

而项目产生收益需要一定的时间，因此在短期内募投项目新增折旧和摊销将对发行人经营业绩产生一定的影响。

(六) 其他风险

1、“新冠疫情”引致的风险

2020年初，国内突发新冠疫情，给全国乃至全球经济带来了巨大冲击。目前国内的新冠疫情状况已经得到有效控制，但仍然存在零星散发、局部爆发和境外输入的情形，尤其是2021年7月-8月扬州爆发的疫情已对子公司江苏汇成的经营造成一定程度上的不利影响；同时，国外新冠疫情形势仍然严峻。若我国当前的新冠疫情防控成效不能保持或国外疫情形势加剧，可能会对宏观经济的正常运行以及公司的业务开展产生不利影响。

2、宏观经济和行业周期波动的风险

公司所封装测试的芯片广泛应用于智能手机、智能穿戴、高清电视、笔记本电脑、平板电脑等各类终端消费产品。受全球宏观经济的波动、行业景气度等因素影响，上述终端产品消费存在一定周期性。宏观经济环境以及终端市场的整体波动可能通过“牛鞭效应”对公司的经营业绩产生一定的影响。

3、首次公开发行股票摊薄即期回报的风险

本次公开发行股票后，公司的总股本及净资产都将大幅增加。由于募集资金投资项目的实施需要一定时间，在项目建成投产后才能产生效益，公司短期内存在因股本总额及净资产增加导致每股收益、净资产收益率等即期回报指标被摊薄的风险。

4、发行失败的风险

股票公开发行是充分市场化的经济行为，如果出现预计发行后总市值不满足选定市值与财务指标上市标准，或首次公开发行股票网下投资者申购数量低于网下初始发行量等情况，按照《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等相关法律法规的规定，应当中止发行，公司存在发行失败的风险。

八、发行人市场前景分析

（一）发行人所处行业发展前景良好

1、集成电路行业发展前景分析

（1）产业政策扶持及中美贸易摩擦，加快集成电路进口替代进程

我国持续出台集成电路相关产业政策，将其列为国家重点战略产业，对集成电路企业在税收、人才、技术等多方面提供支持，在此政策红利下，我国集成电路企业逐渐转亏为盈并发展壮大，国际地位也有所提升，产能逐渐向中国大陆转移。另外，随着中美贸易摩擦的出现，美国限制了境内部分企业对芯片以及集成电路设备的进口，我国在集成电路各产业链环节实现自主可控已迫在眉睫。

2021年1月，工信部发布公告筹建全国集成电路标准化技术委员会，主要负责集成电路产业标准制修订工作，涵盖产业上游的材料和设备、制造过程中的“设计、流片、封测”、集成电路封装、产品配套应用等领域。行业标准的制定也彰显了进口替代已上升到国家政策层面。

（2）摩尔定律逼近极限，延续摩尔和扩展摩尔成为未来技术发展趋势

摩尔定律是一个基于集成电路实际生产所得出来的结果。随着集成电路尺寸不断减小，技术瓶颈在制约工艺的发展，当前产品换代速度已下降，目前延续摩尔以及扩展摩尔是业界认可较为容易实现集成电路突破的两大发展方向。延续摩尔是指通过改变相关器件的结构和布局来实现不同功能的电子元件按设计组合成一块芯片，系统芯片（SoC）是高度集成的芯片产品，是延续摩尔的一个重要应用。扩展摩尔是指通过将不同功能的芯片和元件组装拼接在一起封装，实现提升芯片功能的目的。其中，封装工艺技术将极大程度的影响扩展摩尔能否在后摩尔时代实现突破。未来，中长期来看，以小尺寸 SoC 为代表的延续摩尔，以及以系统级封装 SiP 技术为代表的扩展摩尔，将会是未来一段时间集成电路产业的发展趋势。

（3）新兴科技产业的发展带来新市场机遇

随着物联网、5G 通信、人工智能、大数据等新技术的不断成熟，消费电子、工业控制、汽车电子、医疗电子、智能制造等集成电路主要下游制造行业的产业升级进程加快。下游市场的革新升级强劲带动了集成电路行业内企业的规模增长。如在显示面板领域，随着电视面板分辨率的提升，每台电视所需显示驱动芯

片颗数几乎成倍增加，每台 4K 电视需使用 10-12 颗显示驱动芯片，而每台 8K 电视使用的显示驱动芯片高达 20 颗。新兴科技产业将成为行业新的市场推动力，并且随着国内企业技术研发实力的不断增强，国内集成电路行业将会出现发展的新契机。

2、封装测试行业发展前景分析

(1) 后摩尔定律时代，先进封装成为行业主流

随着集成电路器件性能的要求不断提高，促进了如 Bumping、Flip Chip、WLCSP、2.5D、3D 等先进封装技术的快速发展。后摩尔定律时代，由于先进制程的研发投入及难度不断提升，制程技术不能带来成本的有效降低，集成电路行业将更多依靠先进封装技术来实现硬件上的突破。先进封装在提升芯片性能方面具有巨大优势，可以在不依赖先进制程工艺前提下，提高芯片整体性能以及集成度，从而满足终端设备对于芯片体积、性能等不断提升的需求。

(2) 产业链分工细化，专业封装测试企业市场地位稳固

随着产业规模的扩张、技术要求的提升，全球集成电路制造产业链分工进一步细化为 Fabless+Foundry+OSAT 的配合，每个环节的分工由此而明确。我国封装测试行业在全球产业链中占据重要地位，并且随着龙头企业的并购整合，市场份额将进一步扩大。另外，随着我国集成电路产业经历了低端制造承接、长期技术引进、高端人才培养等产业发展环节，我国集成电路产业结构逐步完善，形成了以芯片设计为龙头、封装测试为主体、晶圆制造重点统筹的产业布局。未来伴随中国大陆芯片设计业和晶圆制造业的逐步崛起，下游封装测试产业有望持续受益。

(3) 集成电路产业重心转移带来进口替代巨大机遇

目前，中国大陆拥有全球最大且增速最快的集成电路消费市场，集成电路产业发展重心正逐渐转移至中国大陆。巨大的下游市场配合积极的国家产业政策与活跃的社会资本，正在全方位、多角度地支持集成电路行业发展。我国光伏、显示面板、LED 等高新技术行业经过多年发展已达到领先水平，也大力拉动了上游的功率半导体、显示驱动芯片、LED 驱动芯片等集成电路的国产化进程。随着集成电路产业链相关技术的不断突破，加之中国大陆在物联网、人工智能、新

能源汽车等下游市场持续加大布局，中国大陆有望在集成电路封测等更多细分市场实现进口替代。

3、显示驱动芯片封装测试市场发展趋势分析

(1) 行业呈现强者恒强的先发者优势

显示驱动芯片封测为集成电路封测行业内一个较为细分的市场，当前市场内主要企业均已具备成熟的工艺技术以及建立了长期而稳定的客户关系。相较于其他新兴市场，显示驱动芯片封测市场技术迭代相对较慢，前期设备研发投入较大，行业毛利率较低，需通过规模化生产来保证企业的健康发展。因此，行业内领先企业通过与显示驱动芯片设计公司的深度绑定，降低了研发周期，保证了订单的延续性，也增强了企业自身的核心竞争力。行业内新进入的竞争者需要较长时间来获得芯片设计厂商的信任，导致前期的生产需求不足，加大了对于资金的需求。未来，随着行业领先企业继续加深与已有芯片设计厂商的合作，有望进一步扩大市场份额，并对新进入者保持技术及规模优势。

(2) 随着显示技术的不断拓展，显示驱动芯片封测向高度集成化发展

近些年来，国家大力推进超高清视频产业及相关领域的发展和应⽤，4K 和 8K 电视对高动态范围、高色域、高对比度、高光效、高分辨率等方面提出了新的要求，因此发展出了 AMOLED、Mini LED、Micro LED 等新型显示技术。面对新型显示技术，显示驱动芯片要突破尺寸缩小、电流显示均匀性好、芯片输出电流通道间相互串扰小、可靠性高等一系列难题，因此显示驱动芯片的封测需要集成更多数量晶体管以提升芯片性能，而且还需要将多个功能模块封装在同一个芯片里从而实现多功能集成，整体显示驱动芯片的封测向高度集成化发展。

(二) 发行人竞争优势分析

1、领先的技术研发优势

显示驱动芯片封测行业属于技术密集型行业，公司所应用的封测技术均属于高端先进封装形式。公司拥有微间距驱动芯片凸块制造技术、高精度晶圆研磨薄化技术、高稳定性晶圆切割技术、高精度高效内引脚接合工艺等多项较为突出的先进技术与优势工艺，该部分技术在行业内处于发展的前沿，拥有较高的技术壁垒。

公司所掌握的凸块制造技术（Bumping）是高端先进封装的代表性技术之一，通过凸块制造“以点代线”的技术创新，以几何倍数提高了单颗芯片引脚数的物理上限，进而大幅提高了芯片封装的集成度、缩小了模组体积。公司封装工艺中的玻璃覆晶封装（COG）和薄膜覆晶封装（COF）均使用高密度、细间距的倒装凸点互连芯片封装技术。上述工艺基于前沿的倒装芯片（FC）封装技术，结合自身生产工艺与设备进行优化，所封测的产品拥有 I/O 密度高、尺寸小、运算速度快、可靠性高和经济性佳等优势。

公司在研发活动与生产制造过程中积累了大量非专利核心工艺与众多拥有自主知识产权的核心技术，截至本发行保荐书出具日，公司拥有已授权专利 **281** 项，其中发明专利 18 项、实用新型专利 **263** 项，在显示驱动芯片封装测试领域奠定了坚实的技术基础。

2、专业的管理团队优势

公司拥有专业的管理团队，部分核心管理成员曾供职于显示驱动芯片封装测试领域的龙头企业，具备超过 15 年的技术研发或管理经验，具备行业内领先企业的发展视野。公司管理团队对于整个行业的发展以及公司的定位有着较为深刻的认识，是一支经验丰富、结构合理、优势互补的核心团队，为持续提升公司核心竞争力和开发新工艺提供了强有力的人力资源支持。

封测行业客户需求较为多样化，不同的产品需求往往需要不同的生产工艺、技术及管理队伍相匹配，这对封装企业的生产组织能力和质量管理提出了严格的要求。在公司专业管理团队的带领下，公司致力于持续提升生产管理水平和强化质量管理，已具备业内领先的产品品质管控能力，所封装产品具有集成度高、稳定性强、体积轻薄等客户需求的品质，产品良率高达 99.90% 以上，得到行业客户的高度认可。

3、全流程统包生产优势

公司在显示驱动芯片封装测试领域具有领先地位，是中国大陆少数同时拥有 8 吋和 12 吋产线的显示驱动芯片全流程封测企业，业务覆盖了金凸块制造、晶圆测试、玻璃覆晶封装和薄膜覆晶封装完整四段工艺制程，是全球少数可以实现显示驱动芯片封装测试服务一体化的企业。公司提供的全流程服务有效提高了生

产效率、缩短了交付周期、降低了生产成本，并且避免了晶圆测试与封装流程中间长距离周转而导致晶圆被污染的风险。

4、知名客户的资源优势

显示驱动芯片的封装测试厂商需要经过芯片设计公司较长时间的工艺认可，而后才能达成长期合作意向，故存在较高的供应链门槛。凭借稳定的封测良率、灵活的封装设计实现性、生产一体化、不断提升的量产能力、交付及时性等，公司获得了行业内知名客户的广泛认可，已经建立了较强的资源优势。

自成立以来，公司与联咏科技、天钰科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门半导体等行业内知名芯片设计公司建立了稳定的合作关系，其中公司分别于 2020 年和 2021 年上半年获得联咏科技颁发的“最佳配合供应商奖”和“最佳品质供应商奖”，公司所封测芯片已主要应用于京东方、友达光电等知名厂商的面板，2020 年度全球排名前五显示驱动芯片设计公司中三家系公司主要客户，2020 年度中国排名前十显示驱动芯片设计公司中九家系公司主要客户，深厚的客户资源将为公司长期发展带来源源动力。

5、地理与产业集群优势

公司位于中国集成电路产业中心城市合肥，合肥系“一带一路”和长江经济带战略双节点城市，也是长三角区域经济一体化重要城市。合肥市具有良好的产业基础和经营环境，政府大力推进集成电路产业的集群发展，着力打造以合肥为核心的“一核一弧”的集成电路产业空间分布格局。此外，长三角地区是我国集成电路产业集中度最高、产业链最完整、制造水平最高的区域，具有较为显著的范围经济效益，公司立足长三角有利于更贴近客户和原辅材料供应商，产生协同作用。

公司总部位于合肥市综合保税区，目前合肥的集成电路产业已初具规模，产业链上下游从芯片设计、晶圆制造、封装测试到配套材料设备或产成品应用等方面的企业已相对完整，公司上下游企业如晶合集成、京东方、维信诺等均落户合肥或建厂，因而公司深入产业集群之中，可以有效节省运输时间与成本，提高生产响应速度以加快产品交付，缩短供应链周期，有利于享受集成电路产业集群红利。

6、持续扩大的规模优势

显示驱动芯片设计公司选择长期合作伙伴时，着重考虑封装测试厂商是否具备足够的产能规模，是否具备大批量、高品质供货的能力。公司随着合肥生产基地产能及产能利用率的稳步提升，出货规模持续扩大。2020 年度，公司显示驱动芯片封装出货量在全球显示驱动芯片封测领域排名第三，在中国境内排名第一，具有较强的市场竞争力。同时，公司仍在持续购置先进生产设备进行产能扩充，将继续利用规模优势来巩固和提高在全球行业内的竞争地位。

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号），本保荐机构就本次保荐业务中有偿聘请各类第三方机构和个人（以下简称“第三方”）等相关行为进行核查，具体情况如下：

1、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构在本次保荐业务中不存在各类直接或间接有偿聘请第三方的行为，不存在未披露的聘请第三方行为。

2、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐机构对发行人有偿聘请第三方等相关行为进行了专项核查。经核查，发行人在本项目中除聘请海通证券股份有限公司、安徽天禾律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、坤元资产评估有限公司等该类项目依法需聘请的证券服务机构之外，存在直接或间接有偿聘请其他第三方的行为。具体情况如下：

（1）北京荣大科技股份有限公司

为科学地规划募集资金投资项目，顺利完成项目的备案，发行人委托北京荣大科技股份有限公司提供募投项目可行性研究等相关咨询服务，并出具相关报告。北京荣大科技股份有限公司成立于 2014 年 8 月 26 日，注册资本 4,200 万元，法定代表人为韩启磊，经营范围为经营电信业务；技术转让、技术咨询；计算机软件开发及销售；会议服务；礼仪服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售仪器仪表、机械设备、电子产品、办公用品；数据处理。发行人以自有资金向其支付相关咨询服务费。

(2) 弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司

为获取客观可信的行业数据，调研公司市场地位，发行人向弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司购买了行业咨询服务及其相关行业研究报告，其总公司弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司成立于 2003 年 1 月 23 日，注册资本为 30 万美元，法定代表人为王昕，经营范围为企业管理咨询；市场调查（广播电视收听、收视调查除外）；市场分析；投资咨询；营销策划；营销管理培训；项目管理培训；公关关系顾问。发行人以自有资金向其支付相关行业咨询服务费。

(3) 上海泉鸣投资咨询有限公司

为有效推进媒体管理工作以及后续开展路演推介、上市活动等相关工作，提高媒体沟通能力，发行人聘请上海泉鸣投资咨询有限公司为本次发行上市提供财经公关服务。上海泉鸣投资咨询有限公司成立于 2015 年 5 月 18 日，注册资金为 1,000 万元，法定代表人为朱莹，经营范围为投资咨询，财务咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），实业投资，投资管理，市场营销策划，公关活动策划。发行人以自有资金向其支付相关财经公关服务费。

经本保荐机构核查，发行人相关聘请行为合法合规。

十、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论

受合肥新汇成微电子股份有限公司委托，海通证券股份有限公司担任其首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。本保荐机构本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神，对发行人的发行条件、存在的主要问题和风险、发展前景等进行了充分的尽职调查和审慎的核查，就发行人与本次发行的有关事项严格履行了内部审核程序，并通过海通证券内核委员会的审核。

本保荐机构对发行人本次证券发行的推荐结论如下：

发行人符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件中关于首次公开发行股票并在科创板上市的相关要求，本次发行申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。合肥新汇成微电子股份有限公司内部管理良好，业务运行规范，具有良好的发展前景，已具备了首次公开发行股票并在科创板上市的基本条件。因此，本保荐机构同意推荐

合肥新汇成微电子股份有限公司申请首次公开发行股票并在科创板上市,并承担相关的保荐责任。

附件:

《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书》

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: _____

保荐代表人签名: 何立 吴俊 2022年3月28日
何立 吴俊

保荐业务部门负责人签名: 姜诚君 2022年3月28日
姜诚君

内核负责人签名: 张卫东 2022年3月28日
张卫东

保荐业务负责人签名: 任澎 2022年3月28日
任澎

保荐机构总经理签名: 李军 2022年3月28日
李军

保荐机构董事长、法定代表人签名: 周杰 2022年3月28日
周杰

海通证券股份有限公司
2022年3月28日
保荐机构: 海通证券股份有限公司
2022年3月28日

海通证券股份有限公司关于合肥新汇成微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐代表人专项授权书

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及有关文件的规定，我公司指定何立、吴俊担任合肥新汇成微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐代表人，负责该公司股票发行上市的尽职保荐和持续督导等保荐工作事宜。

特此授权。

保荐代表人签名：



何立



吴俊

保荐机构法定代表人签名：



周杰

保荐机构：海通证券股份有限公司

2022年3月28日

